

第 27 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時： 2019 年 9 月 11 日(水) 10:30~16:30

場所： 大阪大学 吹田キャンパス 岡田メモリアルホール(工学部内 R1 棟 3 階 312)

時間	題 目	講 演 者
	司会 松嶋 道也 (大阪大学)	
10:30~ 12:00	『Alインサート材を用いたSolid-Liquid Interdiffusion接合によるダイボンド構造体の冷熱サイクル信頼性向上』 (45分)	○伊藤 宏文、門浦 弘明、桑原 誠、白井 正則((株)豊田中央研究所)
	『 The breakthrough in 48 V interconnect technology and its roadmap to high-voltage solutions 』 (45分)	○Christian Roessle, Thomas Gottwald, Dr. Manuel Martina (Schweizer Electronic AG)
12:00~ 13:10	昼 食 休 憩	
13:10~ 13:20	委 員 会 議 事	
	司会 青島 正貴(トヨタ自動車(株))	
13:20~ 14:50	『パワー半導体実装用接合技術 -Cuナノ粒子接合と特性評価-』 (45分)	○山田 靖(大同大学)
	『異方性高熱伝導材料における面方向熱伝導率測定手法の開発』 (45分)	○西川 剛史、桑原 涼、森 将人(パナソニック(株))、西木 直巳(パナソニックプロダクションエンジニアリング(株))
14:50~ 15:00	休 憩	
	司会 高尾 尚史((株)豊田中央研究所)	
15:00~ 16:30	『マニュアルソルダーリングにおける、はんだ、フラックス飛び散り試験とその対策例』 (45分)	○見島 雄太、山本 輝彦、上谷 孝司(白光(株))
	『超高真空気密を可能とする融解チタンメタライズ法による非金属(セラミックス等)の気密接合技術とその展望』 (45分)	○花土 英昭(カワソーテクセル(株))

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。